

## 宽介电常数聚四氟乙烯玻璃布覆铜箔板 F4BM-1/2

外 观	符合微波印制电路板材料国军标规定指标					
型 号	F4BM220	F4BM255	F4BM265	F4BM300	F4BM350	
介电常数	2.20	2.55	2.65	3.0	3.50	
外型尺寸 (mm)	300×250	350×380	440×550	500×500	460×610	
	600×500	840×840	840×1200	1500×1000		
特殊尺寸可按客户要求压制						
厚度尺寸及公差 (mm)	板厚	0.25	0.5	0.8	1.0	
	公差	±0.02~±0.04				
	板厚	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
	公差	±0.05~±0.07				
板厚包括两面铜箔厚度，特殊尺寸可根据客户要求压制						
机 械 性 能	翘 曲 度	板厚 (mm)	翘曲度最大值 mm/mm			
			光面板	单面板	双面板	
		0.25~0.5	0.03	0.05	0.025	
		0.8~1.0	0.025	0.03	0.020	
		1.5~2.0	0.020	0.025	0.015	
	3.0~5.0	0.015	0.020	0.010		
剪切 冲剪性能	<1mm 的板剪切后无毛刺，两冲孔间距最小为 0.55mm 不分层。 ≥1mm 的板剪切后无毛刺，两冲孔间距最小为 1.10mm 不分层。					
抗剥强度	常态≥18N/cm; 恒定湿热及 260℃±2℃熔融焊料中保持 20 秒不起泡、不分层且抗剥强度≥15 N/cm					
化学性能	根据基材特性可参照印制电路化学腐蚀法加工电路，而材料的介质性能不改变，孔金属化需进行钠萘溶液处理或等离子活化处理。					
物 理 电 气 性 能	指标名称	测试条件		单位	指标数值	
	比 重	常 态		g/cm <sup>3</sup>	2.2~2.3	
	吸水率	在 20±2℃蒸馏水中浸 24 小时		%	≤0.02	
	使用温度	高低温箱		℃	-50~+260	
	热导系数			千卡/米小时℃	0.8	
	热膨胀数	升温 96℃/小时		热膨胀系数×1	≤5×10 <sup>-5</sup>	
	收缩率	沸水中煮 2 小时		%	0.0002	
	表面绝缘电阻	500V 直流	常 态	M. Ω	≥1×10 <sup>4</sup>	
			恒定湿热		≥1×10 <sup>3</sup>	
	体积电阻		常 态	M Ω . cm	≥1×10 <sup>6</sup>	
			恒定湿热		≥1×10 <sup>5</sup>	
	插销电阻	500V 直流	常 态	M Ω	≥1×10 <sup>5</sup>	
			恒定湿热		≥1×10 <sup>3</sup>	
	表面抗电强度		常 态	δ =1mm(kv/mm)	≥1.2	
恒定湿热			≥1.1			
介电常数	10GHZ		ε r	2.20 (±2%) 2.55 (±2%) 2.65 (±2%) 3.0 (±2%) 3.5 (±2%)		
介质损耗角正切值	10GHZ			tg δ		
					≤7×10 <sup>-4</sup>	

联汇芯 始终坚持“诚信为本,质量第一”,的原则。建立长期,稳定的合作伙伴关系,是我们永恒的目标。

如您需要技术支持或报价服务,请联系 Email: LHXPCB888@126.com Tel: 13528895508 Web: www.lianhuixin.com